

SP-23

熱伝導キャップ

LiPOLY SP-23 は、特殊な製法により立体的な熱伝導性シリコンゴムを基材としたキャップです。高熱伝導率、絶縁性、耐衝撃性、組み立ての容易さなどの優れた特性により、TO220 / TO3P、ダイオード、トライオードなどのヒートトランジスタに広く使用されています。

■ 製品の特性

/ 熱伝導率：0.8 W/m*K
/ 良い絶縁性
/ 高回復性
/ 作業しやすい
/ 各厚さには対応可能

■ 製品アプリケーション

/ CPUと放熱シンクの隙間
/ PCコンポーネントと放熱シンクの隙間
/ ノートパソコン
/ パワーサプライ
/ 高速記憶装置
/ 通信設備
/ 5Gの基地局(基幹施設/設備)
/ 電気自動車

■ 製品の形 (長さ×幅×高さ)

/ 11.4mm x 16.0mm x 5.8mm
/ 11.4mm x 21.5mm x 5.8mm
/ 17.5mm x 28.5mm x 5.8mm



■ 代表特性

物理特性	SP-23	試験方法	単位
色	Gray	Visual	-
主成分	Silicone	-	-
厚さ	0.30 / 0.45	ASTM D374	mm
密度	1.8	ASTM D792	g/cm³
硬さ	55	ASTM D2240	Shore A
使用温度	-60~180	-	°C
ROHS & REACH	Compliant	-	-
圧縮特性@1.0mm			
圧縮率@10 psi	1	ASTM D5470 modify	%
圧縮率@20 psi	2	ASTM D5470 modify	%
圧縮率@30 psi	3	ASTM D5470 modify	%
圧縮率@40 psi	4	ASTM D5470 modify	%
圧縮率@50 psi	5	ASTM D5470 modify	%
電気特性			
絶縁破壊電圧	7 / 8	ASTM D149	KV
表面抵抗率	>10 ¹²	ASTM D257	Ohm
体積抵抗率	>10 ¹³	ASTM D257	Ohm-m
熱特性@0.3mm			
熱伝導率	0.8	ASTM D5470	W/m*K
熱抵抗@10 psi	1.110	ASTM D5470	°C-in²/ W
熱抵抗@20 psi	1.058	ASTM D5470	°C-in²/ W
熱抵抗@30 psi	0.988	ASTM D5470	°C-in²/ W
熱抵抗@40 psi	0.929	ASTM D5470	°C-in²/ W
熱抵抗@50 psi	0.897	ASTM D5470	°C-in²/ W

熱抵抗 vs. 圧力

